

# adhäsion

**KLEBEN &  
DICHTEN**

DAS FACHMAGAZIN FÜR INDUSTRIELLE KLEB- UND DICHTTECHNIK

## FÜLLSTOFFE

2K-PUR-Klebstoffe  
mit noch besserer  
Leistung

## AKUSTIKWELLEN- VISKOSIMETER

Präzise Inline-  
Messungen in Echtzeit

## KLEBSTOFFHÄRTUNG

Vorhersage des  
Volumenschumpfs  
dank Simulation



**Bondexpo 2009**

Kleben, Vergießen, Schäumen und Dichten

BONDEXPO 2009

# Kleben, Vergießen, Schäumen, Dichten, Dämmen

Im Wettbewerb der Fügetechniken boomt das Kleben. Das zeigen auch die kontinuierlich steigenden Ausstellerzahlen der Bondexpo, die in diesem Jahr zum dritten Mal als Parallelveranstaltung der Motek vom 21. bis 24. September 2009 in Stuttgart stattfindet. Fast 90 Unternehmen werden auch diesmal dem internationalen Fachpublikum zahlreiche Neu- und Weiterentwicklungen aus der industriellen Kleb- und Dichttechnik präsentieren.

**B**esonderes Augenmerk verdienen in diesem Jahr automatisierbare Applikationslösungen, mit denen es gelingt, die Effizienz in der Montage beim Fügen und Verbinden gleichartiger oder unterschiedlicher Materialien weiter zu erhöhen. Insbesondere beim Verbinden neuer Werkstoffe oder so genannter Hybridmaterialien treten nicht zuletzt wegen ihrer Wirtschaftlichkeit und sicheren Anwendung verstärkt Klebstoffe oder auch kombinierte mechanische und klebtechnische Fügeverfahren auf den Plan. Um hier den Arbeits- und Applikationsaufwand so gering wie möglich zu halten, werden Automationslösungen favorisiert. Während die Bondexpo hierfür sowohl die Klebstoffe als auch die Dosier- und Applikationsgeräte zeigt, werden zahlreiche Aussteller der Motek die zugehörigen Koordinaten-Handlingsysteme sowie Industrieroboter anbieten.

Mit dem Transfer von Erkenntnissen aus Forschung und Entwicklung durch das Fraunhofer IFAM (Bremen) und das TC-Kleben (Übach-Palenberg) wird auf der Sonderschau „Klebtechnische Weiterbildung“ das Informationsangebot der Bondexpo abgerundet.

## Klebtechnische Neu- und Weiterentwicklungen

Die Redaktion hat bereits im Vorfeld der Bondexpo recherchiert. Die folgenden Produktbeispiele zeigen einen Querschnitt aus dem Messeangebot. Alle Exponatbeschreibungen beruhen auf Firmenunterlagen und sollen einen ersten Eindruck vermitteln, was den Messebesucher in Stuttgart erwartet.

## UV-Aushärtegerät auf LED-Basis

Das auf dem Gebiet der Cyanacrylat-, anaeroben sowie UV-härtenden Klebstoffe aktive Unternehmen Cyberbond Europe blickt in diesem Jahr auf eine 10-jährige erfolgreiche Geschäftstätigkeit



Das „Schwanenhals-Design“ des UV-Aushärtegeräts von Cyberbond gewährleistet eine einfache Handhabung.

zurück und nutzt die Bondexpo in Stuttgart insbesondere für die Vorstellung seines UV-Aushärtegeräts Linop U 400. Dieses System basiert auf der LED-Technik und ist – ebenso wie die angebotenen Dosiersysteme – im so genannten Schwanenhals-Design aufgebaut. In der Tischversion sind das Dosierventil und/oder die UV Lampe am Schwanenhals befestigt, so dass der Anwender beide Hände für die einfache Zuführung der Bauteile nutzen kann. Für den Anschluss an eine SPS stehen alle relevanten elektrischen Steckverbindungen zur Verfügung. Insgesamt können bis zu vier Ventile bzw. Lampen parallel gesteuert werden; der Schwanenhals bleibt in diesem Fall ungenutzt.

Weiteres Merkmal ist die leicht nach vorn geneigte Oberfläche, die eine ergonomisch günstige Bedienung erlaubt. Aufgrund des Mikroprozessors können bei den Dosierventilen Zeit und Druck im Dezimalbereich gesteuert werden. Fünf Speicherplätze für individuelle Einstellungen sind ebenfalls vorhanden.

Weitere Infos: Cyberbond Europe GmbH, Halle 7, Stand 7510